

認証書付属書

表1 認証試験時板厚の溶接条件データに基づいた溶接施工条件範囲
(最小及び最大ルート間隔の場合)

板厚 (mm)	最小、最大 ルート間隔 (mm)	溶接電流範囲 (A)	溶接電圧範囲 (V)	溶接速度範囲 (c p m)	パス数
3 2	4	260~330	32~39	20~40	10~13
	1 0	260~330	32~39	15~40	

パス数は、表1に記載の10%増加までのパス数を認める(小数点以下は切り上げ)。

表2 認証試験時データから想定された溶接施工条件範囲

板厚 (mm)	最小、6 mm、最大 ルート間隔 (mm)	溶接電流範囲 (A)	溶接電圧範囲 (V)	溶接速度範囲 (c p m)	パス数
9	4	250~310	31~37	30~40	2
	6	250~310	31~37	20~35	
	1 0	250~310	31~37	15~25	
1 2	4	250~330	31~39	30~40	3~4
	6	250~330	31~39	25~35	
	1 0	250~330	31~39	15~55	
1 6	4	250~330	31~39	20~40	4~6
	6	250~330	31~39	25~45	
	1 0	250~330	31~39	15~55	
1 9	4	250~330	31~39	25~40	5~6
	6	250~330	31~39	25~35	
	1 0	250~330	31~39	15~45	
2 2	4	250~330	31~39	20~40	6~8
	6	250~330	31~39	20~45	
	1 0	250~330	31~39	15~45	
2 5	4	250~330	31~39	25~50	8~11
	6	250~330	31~39	20~50	
	1 0	250~330	31~39	15~45	
2 8	4	260~330	32~39	20~40	8~11
	6	260~330	32~39	20~40	
	1 0	260~330	32~39	15~45	
3 6	4	260~330	32~39	20~45	13~16
	6	260~330	32~39	20~45	
	1 0	260~330	32~39	15~40	
4 0	4	260~330	32~39	20~40	15~19
	6	260~330	32~39	20~45	
	1 0	260~330	32~39	15~40	

パス数は、表2に記載の10%増までのパス数を認める(小数点以下は切り上げ)。

※この溶接施工条件範囲は、認証された溶接条件(40kJ/cm以下、パス間温度350°C以下)で使用しなければならない。